

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-040

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于“金盘转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 自2024年4月11日至2024年4月24日，公司股票在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即44.68元/股。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“金盘转债”的有条件赎回条款，届时根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“金盘转债”。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）同意注册，公司于2022年9月16日向不特定对象共计发行9,767,020张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额97,670.20万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月16日至2028年9月15日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270号文同意，公司97,670.20万元可转换公司债券已于2022年10月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据有关法律法规和《募集说明书》的约定，公司“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，现转股价格调整为34.37元/股。

因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，自2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股；因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转股价格由34.70元/股调整为34.45元/股；因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366股，“金盘转债”转股价格不变；因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价格由34.45元/股调整为34.37元/股。具体内容详见公司前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款可能触发的情况

自2024年4月11日至2024年4月24日，公司股票在连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即44.68元/股。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“金盘转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“金盘转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》和本公司《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“金盘转债”，并及时履行后续审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

联系邮箱：info@jst.com.cn

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日